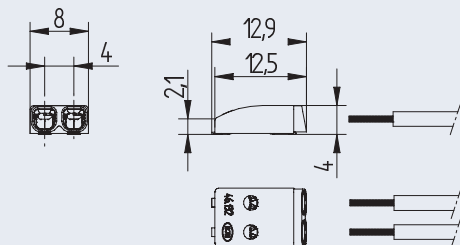
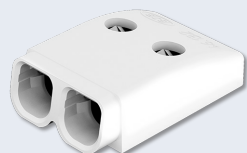


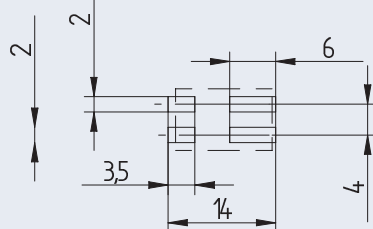
SMD-Leiterplattenklemmen

46.132 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex



Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

Empfohlene Maße für die Lötflächen



SMD-Leiterplattenklemme MiniFlex mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

2-polig - 46.132.2001.50

Direktes Stecken von eindrätigen und feindrätig, verzinnnten Leitern, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion

Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß

Kontaktwerkstoff: CuNi

Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unsere Werkzeug 46.131.U802.89 und 46.131.-397.80

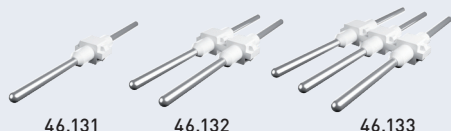
Daten zur Verpackung 46.132.2001.50	
Gewicht SMD-Klemme	0.5 g
Anzahl Klemmen pro Spule	1.750 Stück
Spulendurchmesser Gurtverpackung	381 mm (15")
Gurtbreite	24 mm
Pitchabstand	12 mm
Gewicht pro Spule	1.295 kg
Anzahl Spulen pro Karton	13 Stück
Anzahl SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	22.750 Stück
Gewicht pro Karton	18.10 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 400 mm



Gew. 0.24 g Verp. 1750 Artikel-Nr. 46.132.2001.50

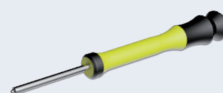
Zubehör:

SMD Mini-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in den Längen 26 mm (U701), 28 mm (U702) und 30 mm (U703) erhältlich.



Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zum Öffnen der Kontakte bei Einsatz von feindrätigen Leitern oder zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter.

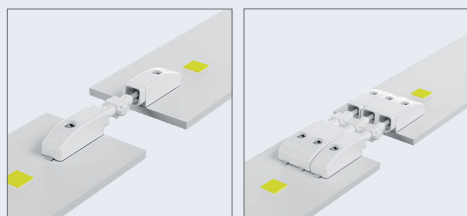


46.131.U802.89



46.131.-397.80

Integrierte Abisolierfunktion bei bereits angezogenen Leiterenden



SMD-Leiterplattenklemmen

46.132 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex
Allgemeine technische Hinweise

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnete Leiter	0.20 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Feindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Abisolierlänge (ø < 2.1 mm)	8 +1 mm
Abisolierlänge (ø 2.1 - 2.7 mm)	9 +1 mm
Leitereinführung	0°
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zur Kontaktöffnung
Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	4 mm / 0.16 inch
Breite	8 mm / 0.32 inch
Höhe	4 mm / 0.16 inch
Tiefe	12.9 mm / 0.51 inch

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	CuNi
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

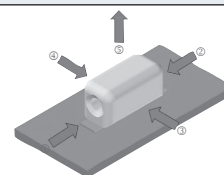
Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120°

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1)	
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977	
Bemessungsspannung UL 1977	320 V
Bemessungsstrom UL 1977	9 A

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE ENEC	EN 60947
UL	cURus, File No. E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007.	
Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
Richtung 1 + 2 Scherkraft längs	70
Richtung 3 + 4 Scherkraft quer	30
Richtung 5 Abzugskraft	30



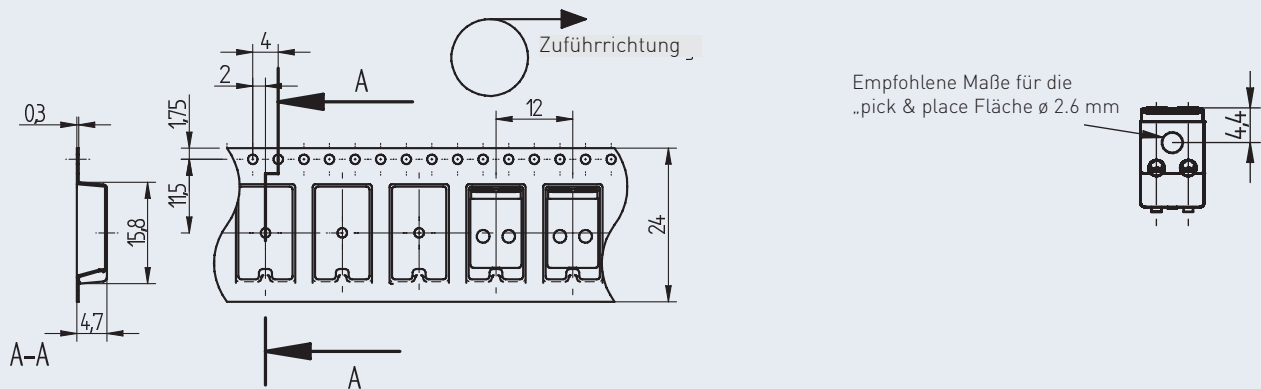
SMD-Leiterplattenklemmen

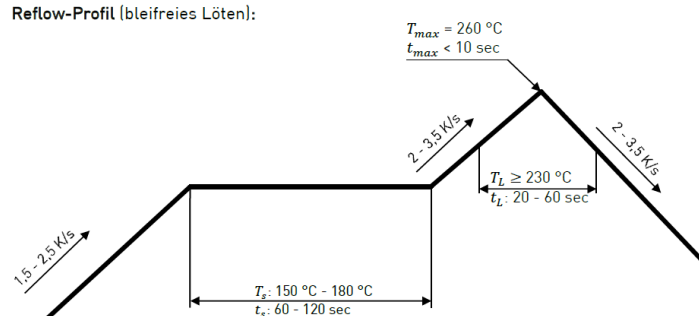
46.132 · SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex
Hinweise zur Verarbeitung

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	<p>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</p> 
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150)